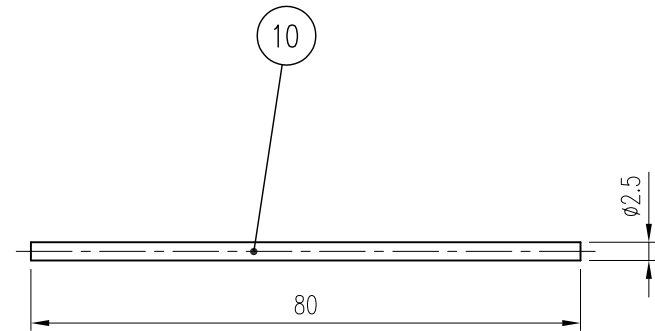
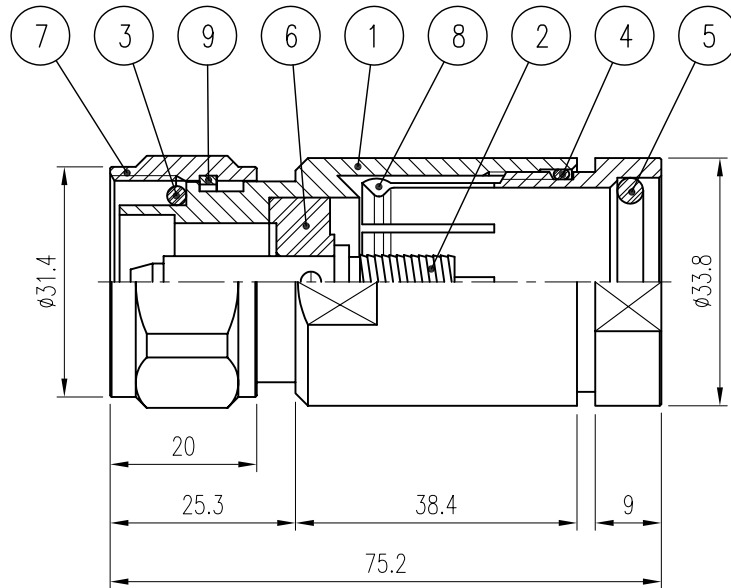


ST	가공										수정내용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										1	도면 양식 변경	손윤호	최영호	2003. 1. 8.	
ST(개선)															



10	HANDLE	1	S45C	Nickel Plate	(X1032)
9	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	(R5003)
8	BACK NUT	1	MBsBD	Silver Plate	(K5016)
7	COUPLING CAP	1	MBsBD	SuCo Plate	(H5065)
6	INSULATOR	1	TEFLON		(H5065)
5	GASKET	1	SILICON		(G5020)
4	GASKET	1	SILICON		(G5019)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00054-N/1 (G5006)
2	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate	(E5079)
1	BODY	1	MBsBD	Silver Plate	(D5079)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2002. 5. 20.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	감도			도명 7/8" F DIN-P			
	제도						
열처리	작성부서		연 구 소		A4도번 CN00570-7/1 K318-087-000		
보호피막처리	적도	NS	단위 mm	총량			